

DOW CORNING

TORAY

Dow Corning Toray Co., Ltd.

東レ・ダウコーニング株式会社
東京都千代田区丸の内 1-1-3
AIG ビル 〒100-0005
TEL:03-3287-8300 (代表)
FAX:03-3287-8460

2009年10月15日

パワー半導体向け4インチ シリコンカーバイド(SiC)ウエハー

量産体制の確立および国内販売を開始

東レ・ダウコーニング株式会社(本社:東京都千代田区/代表取締役社長:大志万 俊夫)は、ダウコーニング社の、パワー半導体向け4インチ^{※1}シリコンカーバイド(SiC)ウエハーの10月量産開始にともない、日本での販売を2010年1月より開始します。従来の3インチ^{※2}SiCウエハーで培ってきた高い技術力・品質を受け継ぎ、大口径化を実現しました。

パワー半導体は、環境問題への関心の高まりから需要拡大が続くクリーンエネルギー市場や、アジア・中国市場における家電製品、電力需要などの市場の急激な拡大に伴い、今後も市場拡大が続くと予測されます。

一方、その基板材料としては、高効率化への期待から従来のシリコン(Si)ウエハーに代わりSiCウエハーが長く検討されています。近年、複数のパワー半導体メーカーがSiC半導体の本格的な事業化に着手しており、SiCウエハーについても、従来主流であった3インチウエハーに代わり4インチウエハーの安定供給と低価格化への要望が高まっています。

ダウコーニング社及び東レ・ダウコーニングは、今回の4インチウエハー量産・販売によりこれらのご要求に応じていきます。

ダウコーニング社の強みは、金属シリコンやエピタキシャルウエハー製造に使用するガスの自社内調達が可能なことであり、SiCウエハービジネスは、ダウコーニング社および東レ・ダウコーニングの事業戦略に一致しています。今後ダウコーニング社は、4インチエピタキシャルウエハーの出荷を2010年第3四半期に予定し、更に6インチ^{※3}ウエハーについても2010年の開発着手を計画しており、将来に渡ってSiCパワー半導体市場の拡大に貢献していきます。

※1 直径約100mm ※2 直径約76mm ※3 直径約150mm

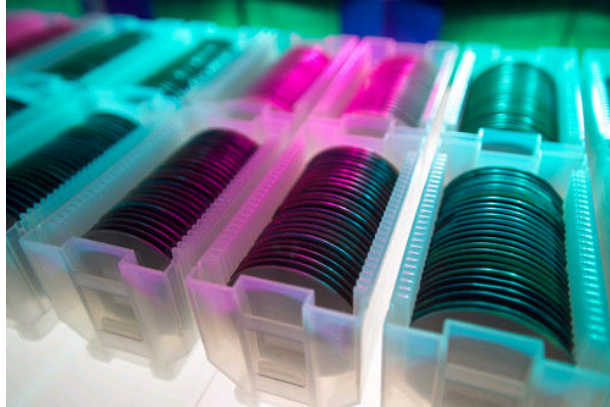


写真 SiC ウエハー

■東レ・ダウコーニング株式会社について

1966年、高分子化学のパイオニアである東レと、世界のシリコン技術革新をリードするダウコーニング社の合併により事業を開始。膨大な研究蓄積を基盤に、最新かつマーケットニーズに即応したシリコンを中心とした機能性素材の開発を行い、さらに顧客企業のグローバル化に呼応して、ダウコーニングとの協力体制のもと世界各所において製品および関連サービスを提供しています。

現在、ダウコーニングは世界で2万5千を超す顧客企業に対応、7千以上の製品およびサービスを提供する、ケイ素関連技術とその革新のグローバル・リーダーです。

本件に関するお問い合わせ先

●報道関係の方からのお問い合わせ

東レ・ダウコーニング株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目1番3号AIGビル
Web : www.dowcorning.co.jp
広報担当 : 高杉記子 TEL : 03-3287-8439 / FAX : 03-3287-1203
E-mail : noriko.takasugi@dowcorning.com

または
新規事業本部 SiC市場開発部 ビジネスディベロップメントマネージャー
矢ノ倉 栄二 TEL : 03-3287-8341 / FAX : 03-3287-1065
E-mail: eiji_yanokura@dowcorning.com

●読者からの製品に関するお問い合わせ

ビジネスセンター TEL : 0120-77-6278